



兼容NXP公司i.MX 8M Mini全系列处理器

## 产品简介

DJ-i.MX 8M Mini-CORE核心板基于NXP（恩智浦）公司嵌入式多核应用处理器i.MX 8M Mini设计，该处理器采用先进的14LPC FinFET工艺技术构建，提供更快的速度和更高的电源效率。凭借商业和工业级认证以及恩智浦产品长期供货计划的支持，i.MX 8M Mini家族可用于任何通用工业和物联网应用。

DJ-i.MX 8M Mini-CORE核心板采用高TG HDI板设计，兼容NXP公司i.MX8M Mini全系列处理器，集成了CPU、DDR4、eMMC、PMU、Ethernet、QSPI，通过两个高可靠性精密工业级座子与底板连接，具有可靠性行高，安装简便的特点。核心板尺寸仅为43mm\*52.2mm，其设计满足于各个不同行业设计需求。

DJ-i.MX 8M Mini-CORE核心板搭载Linux和Android 9.0软件操作系统，可广泛应用于工业控制、医疗仪器、通讯控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、各种终端机市场等领域。

## 产品特点

- ◆ 基于NXP公司嵌入式多核应用处理器，主频最高为1.8GHz；
- ◆ 集成最小系统:主处理器、DDR4 SDRAM、eMMC、QSPI FLASH、PMU;
- ◆ 板载一路板载一路千兆以太网口PHY，支持10M/100M/1000M自适应；
- ◆ 工业级ARM核心板，极佳的稳定性和可靠性；
- ◆ 丰富的行业应用外设接口，MIPI、音频、千兆以太网、M.2 2280 SSD接口、TF卡、WIFI/BT、4G/3G、USB、多串口、RS485、GPIO、RTCWIFI/BT、M.2RS485、UART、USB、GPIO、I2C等接口；
- ◆ 业界极具性价比的Linux和Android工业ARM核心板；
- ◆ 完美支持Linux和Android操作系统，提供系统调用接口API DEMO代码，支持客户上层应用APP开发;
- ◆ HDI沉金PCB板工艺;
- ◆ 超小尺寸：43mm\*52.2mm;
- ◆ 工作电压：DC 5V±10%。

## 核心板两种不同的标准配置

核心板型号	处理器	DDR	Memory	工作温度
DJ-i.MX 8M Mini-CORE:C	MIMX8MM6DVTLZAA	2GB DDR4	16GB eMMC 5.1	0℃~70℃
DJ-i.MX 8M Mini-CORE:I	MIMX8MM6CVTKZAA	2GB DDR4	8GB eMMC 5.1	-40℃~-+85℃

## 核心板规格参数

<b>CPU</b>	CPU	兼容NXP公司的i.MX 8M Mini全系列处理器，可选；标配：MIMX8MM6DVTLZAA或MIMX8MM6CVTKZAA多核处理器：4个Cortex-A53内核平台，每核运行频率高达1.8GHz,1个Cortex-M4内核，运行频率高达400MHz
<b>GPU</b>	GPU	3D GPU (1x shader, OpenGL® ES 2.0), 2D GPU, 根据处理器的不同而不同
<b>存储</b>	内存	标配 2GB DDR4高速内存颗粒
	内置存储器	标配 16GB (商业级) 或8GB (工业级) eMMC 5.1 (可选8GB/32GB/64GB...)
	QSPI FLASH	标配32MB QSPI FLASH
<b>网络</b>	网络	板载1*千兆以太网PHY，支持10M/100M/1000M自适应
<b>B2B连接器</b>	连接器	两个2*50PIN高可靠性、高精度高速连接器，与底板紧密相连
	管脚数	共计200PIN
<b>B2B固定孔</b>	固定孔	4个
<b>电气特性</b>	供电电源	DC 5V, ±5%
<b>操作系统</b>	操作系统	可选Linux、Android
<b>环境</b>	工作环境	温度：-40℃~+85℃自然对流，湿度：10%~90%RH@31℃无冷凝
	存储环境	温度：-40℃~125℃，湿度：5%~95%RH@39℃无冷凝
<b>尺寸</b>	尺寸	超小尺寸：43mm*52.2mm

## 产品尺寸

